

Beijing's Donations to N.Y. Politicians

INTERNATIONAL Newsweek®

CAN BIDEN CONTAIN THE WAR?

**U.S. presidents typically act to rein in Israel and dampen Middle East tensions.
This time looks different**



PLUS:

**A HAMAS
LEADER'S LAST
STAND**

**THE IRAN
FACTOR**

**THE
PALESTINIAN
BACKLASH**

2 7 . 1 0 . 2 0 2 3

ISSN 2052-1081



ALBANIA €6.25	CZECH REP CZK180	HOLLAND €7.00	LEBANON LL10,000	NORWAY NKR119	SERBIA RSD1035
AUSTRIA €10.00	DENMARK DKR57	HONG KONG HK80	LITHUANIA €8.99	OMAN OR 3.250	S LEONE SLL30,000
BAHRAIN BD3.5	EGYPT E€ 65.00	HUNGARY FT1.800	LUXEMBOURG €7.90	POLAND PLN29.99	SINGAPORE \$11.95
BELGIUM €7.00	FINLAND €7.60	IRELAND €7.00	MALTA €7.00	PORTUGAL €7.00	SLOVAKIA €6.50
CHINA RM80	FRANCE €7.50	ISRAEL NIS35	MONTENEGRO €8.30	QATAR QR65	SLOVENIA €8.50
CROATIA HKR70	GERMANY €7.50	ITALY €7.00	MOROCCO MDH70	MALAYSIA RM27.90	SOUTH AFRICA R55.00
CYPRUS €7.00	GIBRALTAR \$6.05	KUWAIT KD3.00	NEW ZEALAND \$14.00	ROMANIA LEI 42.00	SPAIN €7.00
	GREECE €7.50	LATVIA €6.50	NIGERIA \$3.40C	SAUDI ARABIA SR35.00	SWEDEN SKR119
					SWITZERLAND CHF10.60
					UAE AED42
					UK £5.99
					US \$10.99
					ZIMBABWE ZWD4.00

주도적인 PCB 기업, 지속 가능성을 중심으로



“우리는 비즈니스와 기술 파트너와 협력하여 지속 가능한 사회를 조성하고자 노력하고 있다.”

세이지 미요시, FICT 주식회사 대표이사
(2023년 8월 인터뷰)

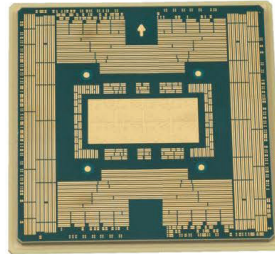
1967년에 후지쯔의 PCB 사업 부문으로 설립된 FICT는 현재는 독립된 기업으로서, 국제 고객을 위한 첨단 PCB 솔루션을 제공하고, 창립 철학을 충실히 지키며 발전하고 있다.

2001년에 회사는 Organic Flip-Chip BGA Substrate (FC-BGA)라는 혁신적인 기술을 개발하여, 이는 이제 반도체 패키지기

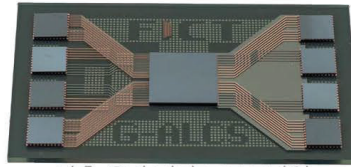
FICT는 글로벌 시장에서 시험용 프로브 카드 분야의 주요 참여자로 자리잡고 있으며, 이는 회사가 지속 가능성을 추구하는 결과이다.

판 세계에서 글로벌 표준이 되고 있다. “이러한 기술을 우리의 프로브 카드 제품에 적용하여 고성능 ST 보드를 개발하였으며, 이를 통해 회사는 시험용 프로브 카드(ST 보드) 분야에서 주요한 참여자로 성장하였다.”라고 FICT의 대표이사 세이지 미요시가 설명했다.

회사가 개발한 다른 중요한 기술은 F-ALCS(F-All Layer Connection Structure)로, 페이스트 채우기와 금속 결합을 통해 인쇄 배선 기판(60층 이상)의 배선 용량을 극대화한다. “이 기술의 독특함은 현재 환경 문제에 대한 우려와 일치한다. 우리는 지속 가능성을



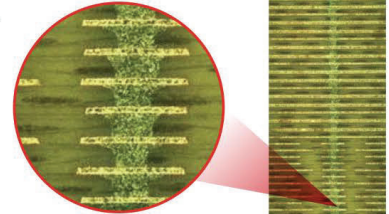
프로브 카드 (ST 보드)



다층 유리 기판 프로토타입 (G-ALCS 기술)

고려하여 폐수 처리와 전력 소모를 최소화하는 대체 공정 솔루션을 찾고 있다.” 라고 미요시는 강조한다. “고속 통신의 영역이 확대되면서, 신호 전송은 이제 100 GHz를 넘어가고 있다. 그러나 기존의 스루홀 스텝은 이 파장 내에서 방해적인 간섭을 일으킨다. 한편, 전도성 페이스트를 사용하면, 일회성 라미네이션 접근법을 가진 우리의 어떤 레이어 IVH(Interstitial Via Hole)는 스텝이 없는 솔루션으로, 끊임없는 고속 전송을 촉진한다.”

더 세밀한 배선 피치를 추구하는 현재의 추세를 고려하



F-ALCS 기술을 활용한 76층 PCB의 단면

면, 유리 기판으로의 전환은 더욱 중요해지고 있다. F-ALCS 기술의 진화인 G-ALCS를 통해, 회사는 이제 라미네이트 유리 기술로의 진화에 주력하고 있다.

“앞으로, 우리는 사업 및 기술 파트너와 고객과 협력하여 첨단 기술을 활용하여 지속 가능한 사회를 구축하는데 기여할 것이다.” 라고 미요시가 전망한다.